



# Orbotech Corus™ 8M

双面成像，性能最大化



Orbotech Corus 8M 是一款全自动直接成像解决方案，旨在取代传统的连线直接成像系统。专为最先进的 HDI（包括 mSAP）和 IC 载板量产而设计，能满足超细线路的成像和出色的对位精度，为 PCB 的设计和生产创造新的机遇。

Orbotech Corus 解决方案采用经由市场验证的新技术，带来了极高的产能和良率的同时结合其精巧、密封、干净的设计理念，确保了生产过程中对于尖端性能和环保制造的要求。



## 优势

### 完全整合的自动化解决方案

- 全自动双面直接成像解决方案旨在取代传统的连线直接成像系统
- 独特的光学设计和超强大的多波长激光系统，适用于超高速成像
- 创新的板材处理和清洁机制

### 卓越的分辨率和对位精度

- 超细、高度均匀的线条结构
- 高精密的设计和先进的涨缩算法确保了卓越的对位精度
- 高景深 (DOF) 确保了在多种高低不均的板上均能实现最佳的线路品质

### 智能运行，支持工业 4.0

- 高速，多靶点识别功能确保了高产能
- 智能的料号队列管理系统，简化工作流程
- 支持工业 4.0，可实现生产流程最佳化和先进的可追溯性

### 降低整体拥有成本 (TCO)

- 结合大镜面扫描技术，实时靶点识别功能和高效自动化实现高产能
- 占地面积小，节省无尘室空间并优化生产线空间利用率
- 高效的能耗

Technologies



DSI™ Technology

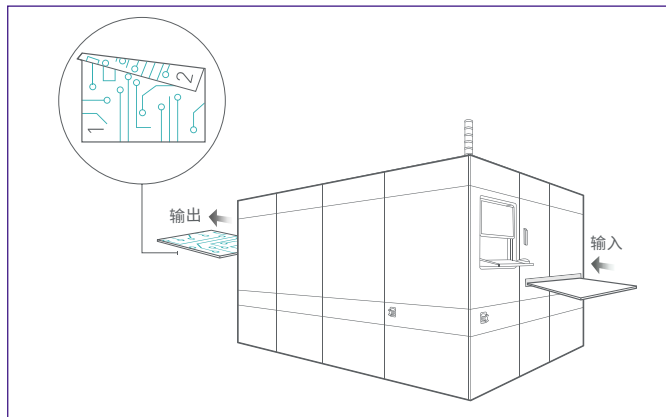


LSO™ Technology



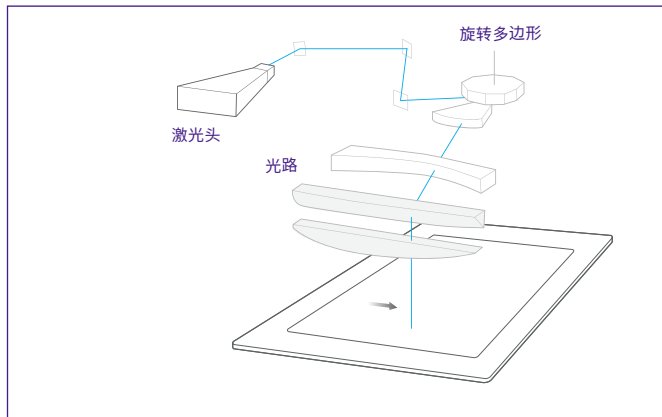
MultiWave Laser™ Technology

## 全自动双面直接成像



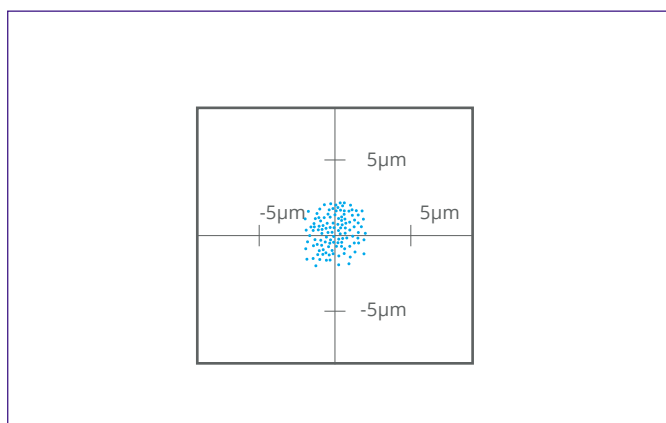
全自动，双面直接成像解决方案，最大限度地提高了批量生产的产能和良率

## 高品质成像



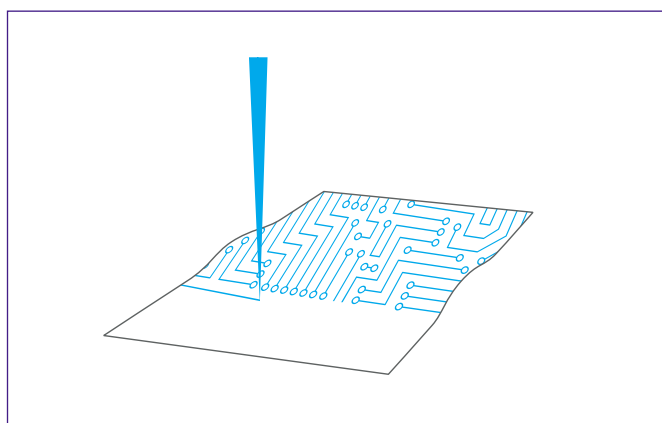
采用 KLA 经由市场验证的 LSO™ (大镜面扫描) 技术，单次曝光就能满足超细线路成像

## 出色的对位精度



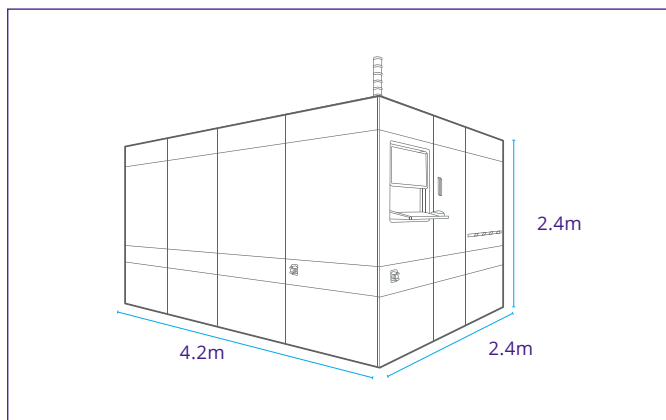
对位精度可精确至  $\pm 5\mu\text{m}$

## 高景深 (DOF)



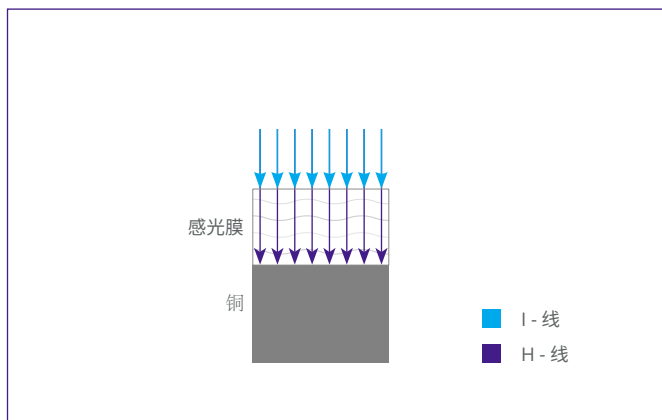
高景深 (DOF) 确保了在多种高低不均的板上均能实现最佳的成像精度和均匀度

## 精巧的一体化设计



完全整合的解决方案结合其精巧、封闭的设计，干净环保的同时也提高了生产效率

## 支持多种感光膜



采用 KLA 经由市场验证的 MultiWave Laser™ (多波长激光) 技术兼容多种感光膜和制程

## 规格

## Orbotech Corus 8M

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 最小线宽 *             | 8μm                       |
| 最小线宽+间距            | 20μm                      |
| 边缘粗糙度, 3σ          | ±1μm                      |
| 对位精度 (FTG), 3σ     | ±5μm                      |
| 层间对位精度 (FTB), 3σ   | 10μm                      |
| 最大基板尺寸             | 660mm x 660mm (26" x 26") |
| 最大曝光尺寸             | 635mm x 660mm (25" x 26") |
| 尺寸 (l) x (w) x (h) | 4.2m x 2.4m x 2.4m        |

\* 取决于感光膜特性和制程

## KLA 支持

保持系统生产力是 KLA 良率优化解决方案不可或缺的一部分。包括系统维护、全球供应链管理、降低成本和减少报废、系统迁移、性能和生产率提升以及转转售认证设备。

KLA Corporation

[www.orbotech.com/pcb](http://www.orbotech.com/pcb) | [www.kla.com](http://www.kla.com)

Rev 7.0\_7-26-2022

©2022 KLA 公司。所有品牌或产品名称可能为其各自公司的商标。KLA 保留在不另行通知的情况下更改硬件和/或软件规格的权利。